

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

メモリ・テスト・システム「同時測定数拡張版 T5503」を販売開始

## 従来比2倍のスループット 業界初、256個のDDR3を同時試験

株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区 社長:丸山利雄)は、DDR3-SDRAM向けに業界初の256個同時試験を実現したメモリ・テスト・システム「同時測定数拡張版 T5503 (正式名称:T5503 8448チャンネル テスト・ヘッド)」を開発し、5月より販売を開始いたしました。

### ■ 開発の背景

パソコンやサーバなどに使用されるマイクロプロセッサのデータ処理の高速化や低消費電力化に伴い、それらのメイン・メモリに使用される DRAM も、従来の DDR2-SDRAM から、より高速かつ低消費電力の DDR3-SDRAM への移行が始まっています。今後、DDR3-SDRAM は、パソコンやサーバのみならず、携帯電話やカー・ナビゲーション・システムなど幅広い分野に普及するものと予想されています。そのため DDR3-SDRAM の量産時期を控え、テスト・システムのさらなるスループット向上が半導体メーカーでの課題となっております。

### ■ 新製品の特長

#### (1) 業界初の 256 個同時試験を実現

従来型の T5503 では 128 個の DDR3-SDRAM を同時に試験することが可能でしたが、このたびの「同時測定数拡張版 T5503」では、256 個の DDR3-SDRAM の同時試験を業界で初めて実現しました。従来比 2 倍のスループット向上により、DDR3-SDRAM の本格的な量産体制でのテスト・コスト削減に大きく貢献します。

#### (2) ダイナミック・テスト・ハンドラ M6242 と接続可能

半導体の試験工程においては、テスト・システムの性能だけではなく、ダイナミック・テスト・ハンドラ(デバイス搬送装置)の性能もスループットに大きな影響を与えます。このたび発売した「同時測定数拡張版 T5503」は、当社最高のスループット(42,200 個/時)と、最高の温度精度の機能を持つダイナミック・テスト・ハンドラ M6242 と接続することで、DDR3-SDRAM の後工程量産試験でのトータル・ソリューションを強力にサポートします。

#### (3) 積層 DRAM の試験に対しても 256 個同時試験可能

複数のベア・チップを積層して 1 パッケージ化した積層 DRAM の試験においては、それぞれのベア・チップに試験信号を入出力する必要があるため、新たに信号を切り替えるためのピンが必要となります。そのため、256 個の積層 DRAM の試験では、ピン数の不足を招くことがありますが、「同時測定数拡張版 T5503」では、オプションのピンカードを追加搭載することで、256 個の同時試験が可能となります。



## 定 価

メモリ・テスト・システム 同時測定数拡張版 T5503  
(正式名称：T5503 8448 チャンネル テスト・ヘッド)  
120 百万円から(構成により異なる)

## 販売目標

初年度 30 台

## 主な仕様

測定対象デバイス: DDR3-SDRAM、GDDR3、GDDR4他  
同時試験個数: 最大 256 個  
最大試験速度: 3.2Gbps

## 製品に関するお問い合わせ先

営業本部 販売戦略統括部 電話:03-3214-7505

\*本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な事象により予告無く変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。